

國立清華大學 函

地址：新竹市光復路2段101號
承辦人：李培菁
電話：03-5715131#42269
傳真：03-5713484
電子信箱：pclee@mx.nthu.edu.tw

受文者：臺北市立松山高級工農職業學校

發文日期：中華民國114年3月24日

發文字號：清奈材中心字第1149002129號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一半導體AI科學營活動海報.pdf、附件二半導體AI科學營課程表.pdf
(114DE00962_1_24110711269.pdf、114DE00962_2_24110711269.pdf)

主旨：為激發學生對半導體領域科學研究之興趣，科林研發股份有限公司與本校奈微與材料科技中心於114年7月14日至18日合作舉辦「半導體AI科學營」，請惠予協助宣傳並鼓勵學生踴躍報名參加，請查照。

說明：

一、旨揭活動訊息說明如下：

(一)活動日期：114年7月14日(一)至18日(五)。

(二)活動時間：每日09:00-19:30。

(三)活動地點：國立清華大學創新育成大樓。

(四)住宿安排：清華會館。

(五)保險：活動期間將投保活動公共意外責任險，參與學員將為其投保旅行平安險。

(六)活動將以中文進行，課程全程免費，並提供餐食。

二、活動採線上報名，報名網址：https://contest.bhuntr.com/tw/lamresearch_sciencecamp/home/。報名期限：114年4月18日(五)17:00。

松山工農 1140324



NOAA1143004021



三、錄取公告：114年5月2日(五)17:00，於「半導體AI科學營」活動網站首頁公告。

四、隨函檢附活動海報與課程表，本活動聯絡窗口：「半導體AI科學營」工作小組聯絡信箱：

lamresearch_sciencecamp@bhuntr.com；聯絡電話：(02) 7730-7613。

五、本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定更動或取消。

正本：全國高級中等學校、高雄市私立高鳳高級工業家事職業學校

副本：

